Half Mode Substrate Integrated Waveguide (HMSIW) Cavities

Eng. Assal Alkhoder^{*}

Dr. Fariz Abboud^{**}

abstract

In this paper, we discuss one way to integrate waveguide cavities with strip lines technologies to obtain a new structure of substrate integrated waveguide cavity which can be an integrated part with other microwave circuits, and it is fabricated by the same technology, where microwave circuits are fabricated using printed circuit board PCB technology, and it characterized by specifications of each the tow technologies, traditional waveguide and planar circuits, concerning the quality factor and the small volume. We propose a new method to reduce the volumes of these substrate integrated waveguide cavities to obtain what is called Half Mode Suabstrate integrated Waveguide HMSIW cavities, where these cavities maintain half of electric and magnetic fields distributions of the Substrate Integrated Waveguide SIW cavity at the same resonant frequency. This cavity has half area of the traditional SIW cavity area, where also it can be fabricated by printed circuit board technology. Results of this paper show that we can use this new kind of SIW cavities in microwave circuits especially microwave filters which are so important in this domain.

Keywords: Substrate Integrated waveguide SIW, Half Mode Substrate Integrated Waveguide HMSIW

For the paper in arabic see page ().

* Master student- Department of Electronics and Communication – Faculty of Mechanical and Electrical Engineering - University of Damascus

** Department of Electronics and Communication – Faculty of Mechanical and Electrical Engineering - University of Damascus

فجوات أدلة الموجة الشرائحية ذات نصف النمط HMSIW

د. فریز عبود **

م أسل الخضر *

الملخص

نناقش في ورقة البحث هذه إحدى طرق دمج فجوات أدلة الموجة مع تقنيات النواقل الشرائحية لنحصل على بنية فجوة دليل موجة شرائحية SIW يمكن أن تكون جزء مدمج بدارات الأمواج الميكروية الأخرى ويتم تصنيعها بنفس التقنية، حيث يتم تصنيع دارات الأمواج الميكروية باستخدام تقنية بطاقات الدارات المطبوعة PCB، كما أنها تمتاز بشيء من مزايا كل من تقنيتي أدلة الموجة التقليدية والنواقل الشرائحية كعامل الجودة الجيد وصغر الحجوم. نقترح طريقة جديدة لتصغير حجوم هذه الفجوات الشرائحية لنحصل على ما يسمى بفجوات أدلة الموجة ذات نصف النمط اللحجوم. نقتر طريقة جديدة لتصغير حجوم هذه الفجوات حيث يمرائحي والمغناطيسي للفجوة SIW عند نفس تردد الرنين. تتميز هذه الفجوات بأن لها نصف مساحة الفجوة بنصف توزع الحقلين حيث يمكن تصنيعها أيضاً بتقنية بطاقات الدارات المطبوعة جديدة الفجوات بالفجوة بنصف توزع الحقلين الشرائحية في دارات الأمواج الفجوة SIW عند نفس تردد الرنين. تتميز هذه الفجوات بأن لها نصف مساحة الفجوة بلقليدية، حيث يمكن تصنيعها أيضاً بتقنية بطاقات الدارات المطبوعة. تبين نتائج هذه الفجوات بأن لها نصف مساحة الفجوة التقليدية، حيث يمكن تصنيعها أيضاً بتقنية بطاقات الدارات المطبوعة. تبين نتائج هذه الورقة أنه يمكن اعتماد هذا الفوع الموات الشرائحية في دارات الأمواج الميكروية ولا سيما مرشحات الأمواج الميكروية ذات الأهمية البالغة في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: أدلة الموجة الشر ائحية SIW، فجو ات أدلة الموجة ذات نصف النمط HMSIW

* أُعد هذا البحث في سياق رسالة الماجستير للمهندس أسل الخضر بإشراف الدكتور فريز عبود – قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات – كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية – جامعة دمشق

** قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات – كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية – جامعة دمشق.

1۔ مقدمة

لقد تم بناء العناصر التي تعمل ضمن مجال الأمواج الميكروية والميليمترية تقليديأ باستخدام تقنية أدلة الموجة والتي تكون فيها المفاقيد منخفضة وعامل الجودة عالى. وعادة ما نتجنب استخدام التقنيات المسطحة عند الحاجة إلى عوامل جودة عالية ومفاقيد منخفضة بسبب انخفاض عامل جودتها وارتفاع مفاقيدها الناتج عن وجود مادة الشريحة العازلة. وبالرغم من ذلك ومع تطور تقنية micromachining من الممكن تصنيع رنانات بخطوط (Coplanar Waveguide) CPW أو microstrip معلَّقة على غشاء membrane [1]، وفجوات رنانة بأنماط منتشرة أو متلاشية [2,3]، ورنانات عازلة [4]. وهذا يمكننا من الحصول على عناصر ذات عامل جودة عالى ومفاقيد منخفضة، والتى يمكن دمجها monolithically مع عناصر أخرى فعالة وغير فعالة على شريحة واحدة. إن أدلة الموجة والرنانات التي تعتمد عليها شيء أساسى في هندسة الأمواج الميكروية وتشكل إحدى أهم المجموعات في دارات الأمواج الميكروية ولا سيما في تصميم المرشحات.

وحيث أن المتطلبات الأساسية في نظم الاتصالات والرادارات الحديثة هي فقد التحويل (insertion loss) المنخفض والحجوم المنخفضة ورفض عالي في مجال المنع مع الحفاظ على تكاليف منخفضة. تؤمن لنا تقنية SIW (SIW trate على تكاليف منخفضة. تؤمن لنا تقنية (Integrated Waveguide المرشحات. فهي ذات حجوم وأوزان صغيرة بينما تحافظ على أداء عالي [5]. وبالرغم من ذلك فإن عامل الجودة غير المحمل لفجوات SIW ينخفض مع ازدياد التردد. سنهتم في ورقة البحث هذه بالمبادئ الأساسية

لدليل الموجة الشرائحي SIW. وسنجري مراجعة حول أدلة الموجة الشرائحية SIW بتشكيلة مختلفة تقودنا إلى فجوات نصف النمط. وسنذكر أهم ميزات بعض البنى وحيدة الطبقة. ومن ثم سننتقل إلى شكل جديد من الفجوات الرنانة المشكلة بتقنية SIW.

2- أدلة الموجة الشرائحية SIW التقليدية

<u>تُعرف</u> تقنية التصميم التي يتم فيها دمج دليل موجة مستطيل بالدارات المسطحة على نفس الشريحة العازلة باستخدام تقنية الدارات المدمجة بالنواقل الشرائحية (Microstrip-Integrated-Circuit) MIC Substrate Integrated) SIW (Microstrip Integrated) <u>أدلة الموجة الشرائحية</u> SIW (Substrate Integrated) الصعوبات التي نواجهها مع أدلة الموجة المستطيلة الصعوبات التي نواجهها مع أدلة الموجة المستطيلة الميكروية الأخرى. تحتفظ بنية SIW بمميزات دليل الموجة المستطيل التقليدي ذو العرض الذي يساوي الموجة المستطيل ما يسمح باستخدام نفس تقنيات التحليل والتصميم لهذه البني.

يبين الشكل (1) دليل موجة شرائحي SIW. إن المبدأ العام لهذا النوع من أدلة الموجة هو ما يسمى بأدلة الموجة ذات الجدران الجانبية التي تتشكل من أعمدة post-wall [6]. فإذا حفرنا في شريحة عازلة صفين من الثقوب وطلينا جدرانها الداخلية بالمعدن فإننا سنحصل على دليل موجة ذو جدران جانبية على شكل أعمدة معدنية، هذا الدليل مملوء بعازل له ثابت عازلية الشريحة العازلة، حيث أن وجهي الشريحة العازلة وبين صفي الثقوب على الأقل سيكونان مطليين بالمعدن. تشير الدراسات المرجعية [6] إلى أن الموجة التي تنتشر ضمن الدليل لان تتسرب من بين الثقوب المطلية بالمعدن عندما تكون

المسافة الفاصلة بين الثقوب المتجاورة صغيرة بالنسبة لطول الموجة المنتشرة ضمن الدليل SIW. وكي تنتشر الموجة الميكروية ضمن الدليل SIW دون حدوث تسريب يجب أن يتحقق الشرطين التاليين: [6,7]

$$B < \frac{\lambda_0 \cdot \sqrt{\varepsilon_r}}{2} \tag{1}$$

$$B < 4D \tag{2}$$

حيث D هي قطر الثقوب المشكلة للجدران، B المسافة بين ثقيين متجاور بن.



شكل (1) دليل موجة شرائحي SIW

وبالتالي فإن الدليل الشرائحي SIW يكافئ دليل موجة مستطيل تقليدي، ويمكن تحليله وتصميمه بالنسبة للنمط الأساسي كدليل موجة مستطيل وذلك باستبدال البعد العريض لدليل الموجة المستطيل وهو a بالعرض الفعلي للدليل الشرائحي SIW، وبحيث تكون المسافات الفاصلة بين الثقوب الممعدنة المتجاورة صغيرة بما يكفي. ويمكننا أن نشتق العرض الفعلي للدليل الشرائحي SIW بالتقريب التالي: [7]

$$w_{eff} = w - \frac{D^2}{0.95B} \tag{3}$$

3- فجوات SIW

تتميز الدارات المصنعة بتقنية الدارات المطبوعة PCB كما ذكرنا سابقاً بسهولة التصنيع

وسهولة الدمج بين الدارات التي يمكن أن تنفذ على نفس البطاقة بينما تتميز الفجوات الرنانة التقليدية بعامل الجودة العالي.

3-1 فجوات SIW الرنانة التقليدية

يتم تنفيذ فجوة رنانة بتقنية SIW بحصر جزء من المادة العازلة للبطاقة العازلة المطلية من وجهيها بالمعدن بواسطة أربعة صفوف من الثقوب المطلية من الداخل بالمعدن، كما يبين الشكل (2)، فإن الموجة لن تتسرب من بين الثقوب المطلية بالمعدن، وعندها فإن صفوف الثقوب ستمثل جداراً كهربائياً مكافئاً (E = 0) وسنحصل على فجوة دليل موجة شرائحية SIW، [7,8].



شكل (2) فجوة SIW رنانة

ينطبق على فجوات SIW الرنانة ما ينطبق على فجوات أدلة الموجة التقليدية المملوءة بعازل ولكن بعد استبدال الأبعاد الأفقية لها بأبعاد مكافئة (من أجل حساب تردد الرنين مثلاً). فيعطى تردد الرنين للنمط TE_{m0n}

$$f_{m0n} = \frac{c_0}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{l_{eff}}\right)^2 + \left(\frac{n}{w_{eff}}\right)^2} \quad (4)$$

حيث نعتبر هنا أن ارتفاع الشريحة العازلة أي ارتفاع الدليل SIW والمقابل للبعد b في دليل الموجة التقليدي

صغيراً جداً (البعدين a و b في دليل الموجة المستطيل التقليدي يكافئان البعدين w_{eff} و w_{eff} في الدليل الشرائحي (SIW)، ومن هنا فإن الدليل *mln* في تردد الرنين للنمط TE_{m0n} سيصبح *m*0*n* أي أن *I* يساوي الصفر حيث أن ارتفاع الدليل SIW أصغر من نصف طول الموجة (*I* تمثل عدد أنصاف طول الموجة في ارتفاع الدليل). أما w_{eff} و اللذين يحسبان من العلاقات التالية: [7.8]

$$w_{eff} = w - \frac{D^2}{0.95B} \tag{5}$$

$$l_{eff} = l - \frac{D^2}{0.95B} \tag{6}$$

D هو قطر الثقوب المعدنية و B هي المسافة بين اثنين متجاورين منها (I هنا هي الطول الفيزيائي للفجوة الشرائحية وليست هي البعد الثاني من الدليل mln). c_0 هي سرعة انتشار الضوء في الخلاء μ_r و π هما ثابت النفاذية المغناطيسية وثابت عازلية البطاقة العازلة التي النفاذية المغناطيسية وثابت عازلية البطاقة العازلة التي نبني عليها الـSIW [9]. نهتم هنا بالنمط TE_{m0n} لأن الأبعاد الأفقية لفجوة SIW كبيرة قياساً بارتفاعها، ومن هنا في معظم الحالات فإن ارتفاع الشريحة سيكون صغير بالنسبة لنصف طول الموجة عند تردد الرنين، بالتالي نأخذ حالة *J* تساوي الصفر بينما كل من *m* و *n* لا تساوي الصفر.

كما يمكننا أن نستخدم علاقات حساب الحقلين الكهربائي والمغناطيسي في الفجوة المستطيلة التقليدية على فجوات SIW الرنانة، فيمكننا أن نستخدم العلاقات على فجوات M_{eff} و d - h و h - d و h - h [10]

$$E_{y} = \frac{-2A^{+}k_{m\ln}Z_{0}a}{\pi}\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{\pi z}{d} \quad (7)$$

$$H_x = \frac{2jA^+a}{d}\sin\frac{\pi x}{a}\cos\frac{\pi z}{d} \qquad (8)$$

$$H_z = -2jA^+ \cos\frac{\pi x}{a}\sin\frac{\pi z}{d} \qquad (9)$$

حيث أن *k_{mln} هو ر*قم موجة النمط *mln، و*الذي يُعطى . بالعلاقة التالية:

$$k_{m\ln} = \left[\left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{l\pi}{b} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{d} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

ويجب أن نضيف أيضاً أن التقريبات التي ذكرناها في العلاقات الأخيرة السابقة صحيحة من أجل الشرطين (1) و (2). [11,12]

3-2 فجوات SIW الرنانة المطوية

إن الغاية من هذا النوع من الفجوات الرنانة قياساً بالرنانات SIW التقليدية هو الحصول على مساحات أصغر للدارات المشكلة من هذا النوع من الفجوات الرنانة. وبالتالي يمكننا أن نحصل باستخدام الفجوات الرنانة الشرائحية المطوية على دارات أمواج الفجوات الرنانة الشرائحية المطوية على دارات أمواج ميكروية لها حجوم أصغر من التي تستخدم الفجوات الشرائحية SIW [13,17,18]. يمكننا أن نطبق نفس طريقة طي فجوات أدلة الموجة التقليدية [14,15] من أجل تشكيل فجوات مطوية بتقنية SIW لنحصل على ما أجل تشكيل فجوات أدلة الموجة المطوية الشرائحية SIW يسمى فجوات أدلة الموجة المطوية الشرائحية FSIW Substrate Integrated Folded) أو (Waveguide

Waveguide) [13]. من أجل تنفيذ الرنانات المطوية نحتاج إلى طبقتين من الشرائح العازلة يفصل بينهما طبقة معدنية (طباعة معدنية بتقنية بطاقات الدارات المطبوعة PCB)، جزء من كل من هاتين الشريحتين العازلتين محصور بأربعة صفوف من الثقوب المطلية بالمعدن من الداخل بينما يجب أن يبقى شق في الطبقة المعدنية الفاصلة بين طبقتي العازل على شكل إ على أحد حوافها بين صفوف الثقوب لنحصل على ريانة SIW مطوية تسمى بريانة بنصف طول الموجة الشرائحية المطوية أو رنانة نصف النمط الشرائحية المطوية HMSIFW كما هو مبين في الشكل (3). حيث يُظهر الشكل (3) أن الفجوة أصبحت متوضعة بطبقتين عازلتين يفصل بينهما طبقة معدنية فيها شق بشكل |. من الواضح أننا نختصر الحجم مع هذا النوع من الفجوات إلى نصف حجم الفجوة SIW التقليدية، وبالرغم من أن تصنيعها أصعب ولكن أصبح الأن ممكن مع تطور تقنيات PCB و LTCC .(Low Temperature Cofired Ciramic) .[16,17,8,19]



شكل 3 فجوة HMSIFW رنانة بنصف طول الموجة

كما يمكن استخدام نفس مبدأ الطي لنجري الطي مرة أخرى ونحصل على ما يسمى برنانات ربع طول الموجة الشرائحية أو رنانات ربع النمط الشرائحية [13].

تحتفظ الفجوة الرنانة HMSIFW بكامل نمط الرنين (توزع الحقلين الكهربائي والمغناطيسي) عند تردد

رنينها مقارنة بفجوة SIW الرنانة بالرغم من تسميتها رنانة نصف النمط المطوية، ولذلك من المفيد أن نرى توزع الحقلين الكهربائي والمغناطيسي في هذا النوع من الفجوات الرنانة للمقارنة مع رنانة نصف النمط الجديدة التي توصلنا إليها وسنقوم بعرضها في الفقرة التالية، وهى فجوة رنانة جديدة تحتفظ فقط بنصف نمط الرنين عند نفس تردد رنينها. إن غايتنا هنا هي أن نرى توزع الحقلين الكهربائي والمغناطيسي في فجوة SIW وفجوة HMSIFW لهما نفس تردد الرنين باستخدام برنامج المحاكاة CST Microwave Studio. نستخدم من أجل المحاكاة فجوة أبعادها 20×20×0.0 مم وكل من قطر الثقوب المشكلة للجدران الجانبية والمسافات بينها يساوي mm، حيث المادة التي تملأ الفجوة لها ثابت عازلية نسبى يساوي 4.5 وثابت نفاذية مغناطيسية نسبى يساوي 1. إن الأبعاد المذكورة لنصف قطر الثقوب والمسافات الفاصلة بينها تحقق الشرطين (1) و (2)، نجد بمحاكاة هذه الفجوة بواسطة أداة الحل eigen mode solver والتي تعمل ضمن برنامج solver Studio أن تردد الرنين من أجل هذه الأبعاد يساوي تقريباً 5GHz. يبين الشكل (4) توزعى الحقلين الكهربائي والمغناطيسي في فجوة SIW عند تردد رنينها 5GHz. مع الإشارة إلى أننا نُظهر الحقل الكهربائي في المستوي xy والحقل المغناطيسي في المستوي xz. حيث يشير شكل توزع الحقول إلى أن نمط الرنين هو النمط .TE₁₀₁

بإجراء محاكاة للفجوة المبينة في الشكل بإجراء محاكاة للفجوة المبينة في الشكل (3)، حيث أن h = 0.8 mm، حيث أن تردد الرنين يساوي تقريباً d = b = 0.8 mm، SIW وهو قريب من تردد الرنين للفجوة SIW، وهو قريب من تردد الرنين الفجوة كما يبين الشكل (5) توزع الحقلين الكهربائي



شكل (4) توزع الحقلين الكهربائي والمغناطيسي في فجوة SIW رنانة

والمغناطيسي ضمن هذه الفجوة (HMSIFW). مع الإشارة إلى أننا ومن أجل الفائدة نبين الحقل الكهربائي في المستوي xx والحقل المغناطيسي في المستوي xx، وذلك للمقارنة مع توزعي الحقلين الكهربائي والمغناطيسي لفجوة SIW والمبينين في الشكل (4).

يمكننا أن نرى من الشكلين (4) و (5) أن توزعي الحقلين الكهربائي والمغناطيسي في الفجوة HMSIFW هما نفس التوزع في الفجوة SIW وذلك بالنسبة لجدران الفجوة، أي وكأننا نقوم بطي توزعي الحقلين الكهربائي والمغناطيسي مع طي الفجوة. بينما تأتي تسمية نصف النمط من ناحية أننا إذا نظرنا إلى شكل توزع الحقل من الأعلى فإننا سنرى فقط نصف توزع

الحقل الكهربائي (والمغناطيسي)، إلا أن هذا التوزع يكرر نفسه في كل من الطبقتين العليا والسفلى من الفجوة HMSIFW.

ومن أجل إعادة تردد رنين الفجوة HMSIFW ومن أجل إعادة تردد رنين الفجوة GHz ولي إلى 5 GHz تجد باستخدام برنامج المحاكاة نفسه أن إ يجب أن تصبح mm 20.36 mm متقاربين. إلا أنه عندما الفجوتين SIW و HMSIFW متقاربين. إلا أنه عندما نتحدث عن دارات الأمواج الميكروية التي تستخدم الشرائح العازلة فإننا نسعى إلى تصغير المساحات التي تشغلها عناصر الأمواج الميكروية وليس حجومها، إذ أن سماكة الشريحة العازلة يُعتبر صغير مقارنةً بسطح أو مساحة العنصر. وعلى ذلك يمكننا أن نرى أن أننا



شكل (5) توزع الحقلين الكهربائي والمغناطيسي في فجوة HMSIFW رنانة

أيامنا هذه تصنيع البطاقات متعددة الطبقات، إلا أن ذلك عند ترددات منخفضة، إذ أن المواد المستخدمة في لصق طبقتين من الشرائح العازلة ستجعل وسط الانتشار غير متجانس، ويزداد هذا اللاتجانس مع زيادة التردد ما يؤثر على أداء العناصر التي تعتمد هذه الفجوات. ومن هنا يوجد مساعي حثيثة لتصغير مساحات الفجوات SIW بطرق أخرى. منها مثلاً زيادة ثابت عازلية الشرائح المستخدمة، ما يؤدي إلى نقصان طول الموجة ضمن المادة العزلة وبالتالى تصغير مساحات هذه الفجوات. اختصرنا هنا سطح الفجوة الرنانة إلى النصف تقريباً بانتقالنا من الفجوة SIW إلى فجوة HMSIW، وهذا سينعكس على العناصر التي تستخدم هذه الأنواع من الفجوات (كمرشحات الأمواج الميكروية مثلاً)، حتى ولو كان ليس بنفس المقدار. إلا أن تصنيع فجوات HMSIFW نتطلب تقنية بطاقات الدارات المطبوعة HMSIFW تتطلب تقنية بطاقات متعددة الطبقات، وهذا يضيف صعوبة أو نقطة سلبية على فجوات HMSIFW مقابل فجوات SIW التي تحتاج تقنية فجوات PCB بطبقة واحدة فقط. حتى ولو كان من السهل جداً في

سنرى فيما يلي طريقة أخرى لتصغير حجوم الفجوات SIW الرنانة وذلك باستخدام فجوات تحتفظ بنصف نمط الرنين فقط وليس بكامل نمط الرنين وذلك عند نفس تردد الرنين، كما أنه يمكن استخدام تقنية PCB البسيطة وحيدة الطبقة. وبالتالي كما سنرى سنحصل على فجوة لها نفس مساحة أو سطح قريب من مساحة الفجوة WMSIFW ولها نفس تردد الرنين.

3-3 الفجوات الشرائحية ذات نصف النمط

نقترح في هذه الفقرة رنانة دليل موجة شرائحية بنصف النمط إن المقصود بعبارة رنانة نصف النمط هو أن الرنانة ستحتفظ بنصف نمط الرنين مقارنةً بفجوة SIW تقليدية عند نفس تردد الرنين وبالتالي فإن حجم الفجوة الرنانة الجديدة سيساوي نصف حجم الرنانة الأساسية دون اللجوء إلى طي الرنانة. نحصل على هذه الرنانة من اقتطاع نصف الرنانة SIW الأساسية دون أن نلجأ إلى الطي كما هو مبين الشكل (6).

إن الغاية من هذا النوع من الفجوات الرنانة قياساً بالرنانات SIW التقليدية والمطوية هو الحصول على مساحات أصغر للدارات المشكلة من هذا النوع من الفجوات الرنانة بالإضافة إلى أنها تمتاز عن الفجوات الرنانة المطوية بأنه يمكن تنفيذها على طبقة واحدة بتقنية الدارات المطبوعة PCB. ولكي نفهم كيفية الحصول على هذا النوع من الفجوات الشرائحية يمكننا أن نتخيل أننا نقتطع نصف الفجوة SIW.

إذا وباستخدام تقنية PCB يمكننا أن نحصل على ما نسميه فجوات أدلة الموجة الشرائحية ذات نصف النمط (فجوات HMSIW) كما هو مبين في الشكل (6). ونحتاج من أجل تنفيذ هذا النوع من الرنانات إلى طبقة واحدة فقط من الشريحة العازلة مطلية من الأسفل بينما



شكل (6) فجوة HMSIW رنانة بتقنية PCB

يأخذ طلاء الطبقة العليا الشكل المبين في الشكل (6)، وتكون الشريحة التي تشكل الطبقة العليا من الطلاء محاطة على الأقل بثلاثة صفوف من الثقوب المطلية بالمعدن من الداخل من أجل فجوات HMSIW، بينما يجب أن يبقى شق في الطبقة المعدنية العليا على شكل إ على أحد حوافها بين صفوف الثقوب لنحصل على فجوة على أحد حوافها بين صفوف الثقوب لنحصل على فجوة إحاطة فجوة HMSIW بأربعة صفوف من الثقوب المطلية بالمعدن من الداخل مع المحافظة على شكل الشق المذكور.

بإجراء محاكاة للفجوة المبينة في الشكل (6) مع المحافظة على الأبعاد mm 20 = l وارتفاع الشريحة العازلة mm 0.8 mm سنجد أن تردد الرنين قد ازداد إلى 5.148 GHz تقريباً. بينما يبين الشكل (7) توزع الحقلين الكهربائي والمغناطيسي ضمن هذه الفجوة. إن هذه الفجوة مفتوحة من الأعلى عن طريق الشق المذكور سابقاً، وبالتالي فإن الأمواج المنتشرة ضمن الفجوة منطقة هوائية ارتفاعها mm 5 فوق الفجوة كما يبين الشكل (7). يمكننا أن نرى من الشكل (7) أن الموجة تنتشر خارج الفجوة في المنطقة الهوائية، حتى ولو كانت كثافة الحقول خارج الفجوة وهذا يضيف نقطة سلبية إلى الفجوة

							· · ·	1 . 1 . 		·	-21				U/m 1.40e9 1.31e9 9.62e8 7.87e8 6.12e8 4.37e8 2.62e8 8.75e7 0
Type Monitor Plane at z Maximum-2D Frequency Phase	E-Field Mode 1 0 1.3994e+ 5.00156 0 degree	(peak) 009 V/m s	at	-9.9	¥ 14 / 6).8 /	-4.3	3681e-	015	1	^		*	*	↓ ×
				个个个个不不	44554 K	* * * * * *		• • • • •	* * * * * *	*****					A/m 5.05e6 4.74e6 4.10e6 3.47e6 2.84e6 2.21e6 1.58e6 9.47e5 3.16e5 0
H-Field (p Mode 1 5.0523e+00 5.00156 90 degrees	peak) 06 A/m at	: -10.3	3023	* / 6	* *	67 /	10.0	924	•	4		4	4	ų.	z •

شكل (7) توزع الحقلين الكهربائي والمغناطيسي في فجوة HMSIW

الفجوة، وبالتالي لا بد من زيادة أبعادها الأفقية لإعادة تردد الرنين إلى التردد 5GHz، وباستخدام برنامج المحاكاة نجد أن تردد الرنين يصبح 5GHz من أجل المحاكاة نجد أن تردد الرنين يصبح 5GHz من أجل الفجوة بنسبة 20.65 تقريباً. أي بالمحصلة نختصر مساحة الفجوة بنسبة 0.562 تقريباً عند الانتقال من الفجوة SIW إلى الفجوة MMSIW. أما بالنسبة لعلبة التحجيب فيكفي أن يكون ارتفاعها كبير بالنسبة لارتفاع الشريحة العازلة مقسوماً بالجذر التربيعي لثابت عازلية الشريحة نفسها كي تكون كثافة الحقول ضمن المنطقة الهوائية في الفجوة الجديدة HMSIW. إذ أن هذا الانتشار خارج الفجوة سيؤدي إلى تداخل مع دارات الأمواج الميكروية التي يمكن أن تتواجد مع الفجوة على نفس الشريحة العازلة، أو أن الفجوة ستتأثر بوجود تلك الدارات. وبالمحصلة فإن هذا الشق المتروك على الوجه العلوي للفجوة سيلعب دور هوائي ولو بأداء ضعيف. ولذلك ومن أجل التخلص من هذه الظاهرة لا بد من تحجيب الفجوة بعلبة معدنية تحصر الحقول ضمن فضاء محدود.

الملاحظة الأخرى هنا هي زيادة تردد رنين هذه

صغير مقارنةً بالكثافة ضمن الشريحة العازلة. ويبقى هذا أن نشير إلى أن وجود علبة التحجيب يشكل نقطة سلبية إلا أن تصنيع هذه العلب المعدنية يبقى أسهل بكثير من تصنيع البطاقات متعددة الطبقات مع المحافظة على تجانس وسط الانتشار.

4- أثر تصغير فجوات SIW الرنانة

سنرى في هذه الفقرة الفرق بين فجوة SIW الكاملة والفجوة HMSIW من حيث عامل الجودة لهذه الفجوات. اخترنا هنا تردد رنين الفجوة 5GHz وهو نفس تردد الرنين الذي اخترناه سابقاً. مع الإشارة هنا إلى أننا لم نأخذ مفاقيد العازل بعين الاعتبار في المحاكاة إذ ما يهمنا هنا هو إيجاد أثر اقتطاع جزء من الفجوة على عامل الجودة وأبعاد الفجوات المدروسة. من المفيد أن ندرس عامل الجودة للفجوة الرنانة بعد وصلها مع الوسط المحيط من أجل المحاكاة. ويشارك نوعين من عامل الجودة للفجوة الرنانة بعد وصلها مع الوسط المحيط الفجوة الرنانة بعد وصلها مع الوسط المحيط عامل من أجل المحاكاة. ويشارك نوعين من عامل الجودة عامل مع الوسط المحيط، عامل من أجل المحاكاة. وعامل مع الوسط المحيط، عامل عامل جودتها قبل التحميل وعامل جودتها مع التحميل، فمقلوب

جودتها قبل وبعد التحميل. ولذلك سنجري محاكاة للفجوات المذكورة من أجل إيجاد عامل الجودة الكلي ودراسة أثر قطع فجوة SIW للحصول على هذه الفجوة المصغرة HMSIW على عامل الجودة. نشير إلى أن هناك عدة طرق لوصل الفجوة WIS مع عدة أنواع من خطوط النقل الشرائحية مثل خط النقل الشرائحي coplanar أو دليل الموجة المستوي stripline ثلاثي الطبقات [11,12,19,20]. يبين الشكل (8) فجوة SIW الكاملة الرنانة مع طريقة وصلها بخط نقل شرائحي المحاكاة من النحية هذه الفجوة. وهي البنية التي نعتمدها في المحاكاة.

نشير هنا إلى أن البعد t المبين في الشكل (8) وهو المسافة بين مركز خط النقل الشرائحي microstrip وزاوية الفجوة يساوي microstrip وهو بعد اعتباطي يؤثر على عامل جودة الفجوة وفقاً لما وجدنا عن طريق المحاكاة، إلا أننا سنختار نفس القيمة في الفجوة HMSIW من أجل المقارنة. كما أن البعد w وهو عرض فتحة الربط بين الفجوة HMSIW وخط



النقل الشرائحي وهو يؤثر أيضاً على عامل جودة الفجوة الكلي أيضاً وفقاً للمحاكاة، ونختاره هنا أيضاً كقيمة اعتباطية تساوي mm 5 ولكن نختار أيضاً نفس القيمة من أجل الفجوة HMSIW أيضاً للمقارنة.

عند إجراء محاكاة للفجوة بنفس الأبعاد المذكورة سابقة فإن تردد الرنين سيتغير بسبب وجود خط النقل الشرائحي ووجود الفتحة بينه وبين الفجوة، ولذلك أعدنا ضبط الأبعاد الأفقية للفجوة لنحصل على نفس تردد الرنين GHz 5 وكان طول وعرض الفجوة الرنين 19.365 mm

يُحسب عامل الجودة الكلي من الاستجابة الترددية للفجوة من العلاقة التالية: [8]

$$Q = \frac{f_0}{BW_{-3dB}} \tag{10}$$

حيث f_0 هو تردد رنين الفجوة و BW_{-3dB} هو عرض مجال التمرير عند 3dB-، ومنه نجد أن عامل جودة فجوة SIW الرنانة الكاملة يساوي تقريباً 130.7. إن عامل الجودة هذا هو عامل الجودة الكلى الذي يتضمن

جزئي عامل الجودة لها قبل وبعد التحميل. تجدر الإشارة هذا إلى أن عامل الجودة لهذه الفجوة يتعلق بعرض فتحة الترابط (المنشئة في صفوف الثقوب الممعدنة) بين الفجوة وخط النقل الشرائحي الميكروي بالإضافة إلى موقع هذه الفتحة أو بعد نقطة وصل خط النقل الشرائحي microstrip عن إحدى حافتي الجهة التي تتغذى منها الفجوة الرنانة. فكلما نقص عرض هذه الفتحة ازداد عامل الجودة. ولقد اخترنا هنا قيم اعتباطية لعرض الفتحة وموقعها ولكنها نفس القيم التي سنختارها في الفجوة HMSIW

عامل جودة فجوة HMSIW

عند قطع فجوة SIW الرنانة كي نحصل على فجوة HMSIW فإننا نحصل باستخدام نفس الأبعاد HMSIW فإننا نحصل باستخدام نفس الأبعاد h = 0.8mm مع المحافظة على mm القيمة الفعلية تردد رنين أقل من 5GHz، ما يدل على القيمة الفعلية للبعد 1 أكبر من قيمتها الفيزيائية، وبالتالي أعدنا ضبط البعد 2 كي نحصل على تردد رنين 5GHz، وتصبح البعد 1 كي نحصل على تردد رنين على 19.68 mm استجابتها الترددية. ويظهر من الشكل أن عامل جودة هذه



شكل (9) استجابة فجوة SIWHM الرنانة

الفجوة يساوي وفقاً للعلاقة (10) 64.1 تقريباً ما يشير إلى انخفاض كبير في عامل جودة هذه الفجوة قياساً بفجوة SIW الكاملة.

نشير هذا إلى أنه تمت محاكاة الفجوة HMSIW مع وجود علبة تحجيب ارتفاعها يساوي mm 5. بإجراء المحاكاة عدة مرات مع تغيير ارتفاع علبة التحجيب نلاحظ تحسن بسيط في عامل الجودة بعد التحجيب. ينتج هذا التحسن البسيط كون الاستطاعة المحصورة ضمن الفجوة المحجبة ستصبح بكثافة أعلى مع نقصان الحجم الداخلى لعلبة التحجيب، أي أن الطاقة المخزنة في الفجوة والمنطقة الهوائية تبقى نفسها ولكن تزداد كثافتها بواحدة الحجوم، ولهذا السبب ازداد معامل الجودة، وهي نتيجة طبيعية يمكننا أن نحصل عليها من بعض المراجع العلمية مثل [8,10]. كما وجدنا من المحاكاة أن ارتفاع فجوة التحجيب يؤثر على تردد الرنين قليلاً، فمثلاً عندما يتغير ارتفاع علبة التحجيب بين 4.5mm و 5.5mm فإن تردد الرنين سيتغير بين 5.02GHz و 4.98GHz تقريباً مع إبقاء باقى الأبعاد ثابتة، بينما يبقى تأثيره صغير جداً على عامل الجودة. في حين أن تغير 5 عرض الشق في الطبقة العليا من الفجوة من 0.1mm حتى 0.8mm يؤدي إلى تغير التردد من 5.02GHz إلى 5GHz تقريباً بينما يتحسن عامل الجودة من 64.1 من أجل s = 0.8 إلى 72.3 تقريباً من أجل s = 0.1، وذلك مع بقاء ارتفاع فجوة التحجيب 5mm. ما يُظهر التحسين الذي يمكن أن نجريه على فجوات HMSIW بتغيير بعد صف الثقوب المطلية بالمعدن عن طرف الفجوة المفتوح بالإضافة إلى المساعدة في تحجيب الفجوة وعزلها عن الدارات المحيطة (إن وُجدَت).

5- خلاصة

اقترحنا طريقة جديدة لتصغير المساحات باقتطاع جزء من الفجوة الرنانة الشرائحية SIW (نصفها) لنحصل على فجوة نصف نمط شرائحية (فجوة (نصفها) رنانة. تحتفظ هذه الفجوة كما وجدنا تقريباً بنصف توزع الحقلين الكهربائي والمغناطيسي مقارنة بفجوة SIW الرنانة التي اقتطعنا منها هذه الفجوة وذلك عند نفس تردد الرنين. ووجدنا أن عامل الجودة ينخفض مع الفجوات الجديدة، وأنه يمكننا تحجيب الفجوة المذكورة لعزلها عن الدارات المحيطة ويمكننا أيضاً مع التحجيب أن نزيد عامل الجودة.

المراجع العلمية

- [11] Stavros Georgakopoulos, Stanislav Ogurtsov ,An S-parameter Extraction Technique for Broad-Band Characterization of Microstrip-to-SIW Transitions, IEEE,2009
- [12] Chyi-kwei Yau, Ting-Yi Huang, Tze-Min Shen, Hung-Yi Chien, Ruey-Beei Wu, Design of 30GHz Transition between Microstrip Line and Substrate Integrated Waveguide, IEEE & Asia-Pacific Microwave Conference 2007,
- [13] Nikolaos Grigoropoulos, Benito Sanz-Izquierdo, and Paul R. Young, "Substrate Integrated Folded Waveguides (SIFW) and Filters," IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS, vol. 15, pp. 829-831, 2005.
- [14] J. S. Hong, "Compact folded-waveguide resonators," Microwave Symposium Digest, 2004 IEEE MTT-S International, vol. 1, 2004.
- [15] J. S. Hong, "Compact folded-waveguide resonators and filters," Microwaves, Antennas and Propagation, IEE Proceedings-, vol. 153, pp. 325-329, 2006.
- [16] Runqi Zhang, Zhigang Wang, Bo Yan, Ruimin Xu, FSIW cavity filter and Derivative FSIW cavity and its filters with LTCC technology, IEEE, 2009
- [17] Hung-Yi Chien, Tze-Min Shen, Ting-Yi Huang, Miniaturized Bandpass Filters With Double-Folded Substrate Integrated Waveguide Resonators in LTCC, IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, VOL. 57, NO. 7, JULY 2009
- [18] Zhang-Cheng Hao1, Wei Hong1, Xiao-Ping Chen1, Ji-Xin Chen1 and Ke Wu, A single-layer folded Substrate Integrated Waveguide (SIW) filter, IEEE, 2005
- [19] Xiao-Ping Chen, Ke Wu ,Low-Loss Ultra-Wideband Transition between Conductor-Backed Coplanar Waveguide and Substrate Integrated Waveguide, IEEE, 2009
- [20] Yan Ding, Ke Wu, Substrate Integrated Waveguide-to-Microstrip Transition in Multilayer Substrate, IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, VOL. 55, NO. 12, DECEMBER 2007

- P. Blondy, A. R. Brown, D. Cros, and G. M. Rebeiz, "Low-loss micromachined filters for millimeter-wave communicationsystems," Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, vol. 46, pp. 2283-2288, 1998.
- [2] J. Papapolymerou, J. C. Cheng, J. East, and L. P. B. Katehi, "A micromachined high-Q X-band resonator," Microwave and Guided Wave Letters, IEEE [see also IEEE Microwave and Wireless Components Letters], vol. 7, pp. 168-170, 1997.
- [3] T. A. Schwarz and L. P. B. Katehi, "A Micromachined Evanescent Mode Resonator," European Microwave Conference, 1999. 29th, vol. 2, 1999.
- [4] B. Guillon, D. Cros, P. Pons, K. Grenier, T. Parra, J. L. Cazaux, J. C. Lalaurie, J.Graffeuil, and R. Plana, "Design and realization of high Q millimeter-wave structures throughmicromachining techniques," Microwave Symposium Digest, 1999 IEEE MTT-S International, vol. 4, 1999.
- [5] D. Deslandes and K. Wu, "Single-substrate integration technique of planar circuits and waveguide filters," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 51, no. 2, pp. 593-596, Feb. 2003.
- [6] Teis Johan Coenen thesis Analysis andDesign of Post-Wall Waveguides for Application in SIW, 2010
- Y. Cassivi, L. Perregrini, P. Arcioni, M. Bressan, K. Wu, and G. Conciauro, "Dispersion characteristics of substrate integrated rectangular waveguide," in IEEE Microwave Wireless Compon. Lett., vol. 12, no. 9, Sep. 2002, pp. 333-335.
- [8] D.M. Pozar, Microwave Engineering, forth ed. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc, 2011.
- [9] D. Deslandes and K. Wu, "Design Consideration and Performance Analysis of Substrate Integrated Waveguide Components," European Microwave Conference, 2002. 32nd, pp. 1-4, 2002.
- [10] Robert E.Collin ,Foundations for microwave Engineering, Mc Graw hill International Editions, Electrical Engineering series.